

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。2018年，公司在董事会的正确领导下，经营稳定增长，取得了较好的业绩，实现营业收入57,239.27万元，同比增长7.69%；实现净利润10,369.41万元，同比增长10.46%，其中归属于母公司股东的净利润10,369.41万元，同比增长10.46%。

现将公司董事会2018年度工作情况汇总如下：

一、2018 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	572,392,694.37	531,505,272.15	7.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,694,105.16	93,870,960.54	10.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,115,858.54	87,603,010.15	4.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,674,688.46	124,426,643.08	-32.75%
基本每股收益（元/股）	1.3088	1.7393	-24.75%
稀释每股收益（元/股）	1.2921	1.7185	-24.81%
加权平均净资产收益率	12.84%	17.25%	-4.41%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,062,305,962.92	941,371,927.52	12.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	876,490,656.82	761,303,037.57	15.13%

二、2018 年经营管理工作回顾

2018 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，继续坚持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念，紧密跟踪传统领域及新兴市场的发展趋势，布局并研发了一批与市场高度契合的新产品，并加大了现有产品的市场推广力度。公司的研发团队、市场销售团队不断充实壮大，特别是一些资深的核心研发人员的加入，使得公司整体研发实力得到明显提升，产品线得以拓展，产品的技术含量得以提高。通过全体员工的一致努力，公司在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器和汽车电子等领域积极拓展，协助重点客户进行产品研发。同时，公司产品在物联网、智能家居、5G 通讯等新兴市场的推广也取得了良好进展，产品逐渐得到客户的认可，并进入批量销售阶段，促进了公司营业收入的增长。同时，由于受到宏观经济不确定性因素的影响，行业下游客户在 2018 年下半年出现采购放缓的迹象，对公司营业收入的成长也产生了一定的影响。

(1) 不断加强技术研发和技术创新能力，重视知识产权保护：

作为国内高端模拟芯片的领先企业，公司历来高度重视研发投入。报告期内，公司研发费用投入 9,265.86 万元，占公司营业收入的 16.19%，完成了 200 余款新产品的研发，涵盖信号链及电源管理两大产品领域。其中，信号链产品包括高性能运算放大器、高压比较器、高保真音频驱动器、高速模拟开关及接口电路等；电源管理产品则涵盖 LED 驱动电路、AMOLED 显示电源芯片、LDO、DC/DC 转换器、微处理器电源监控电路、锂电池充电及保护管理芯片、OVP、马达驱动芯片以及负载开关等多系列产品。随着物联网、可穿戴式设备、智能家居、5G 通讯等新兴市场及应用的快速发展，各类智能设备对芯片性能的要求也在不断提高。公司根据相关市场需求的变化趋势，基于公司芯片产品在高性能、低功耗、小尺寸、高可靠性等方面的技术积累和优势进行了相关新产品的规划，展开了相应的研发工作，特别是针对智能音箱、高保真耳机、传感器信号链、AD/DA 数据转换、智能终端显示屏背光 LED 驱动、LED 闪光灯驱动、AMOLED 显示屏供电管理、锂电池保护及充电管理、微功耗高效电源转换、大电流 DC/DC 电源转换、过压保护（OVP）、负载开关、马达驱动芯片等产品方向推出了一系列达到国际先进水平的新一代模拟芯片产品，如应用于高保真音频设备的无隔直电容、内置开关噪声消除电路的超低失真音频驱动芯片、微功耗零漂移运放、高速 USB 模拟开关、高输入电压锂电池充电器、支持 4 串并联的大动态 LED 背光驱动芯

片、7A 大电流 DC/DC 电源转换器、高效马达驱动芯片等。另外，在制造工艺方面，更多的产品采用了 0.18um 制程的高压 BCD 工艺平台，这将有助于进一步降低芯片功耗、减小芯片面积，满足新一代消费类电子产品、物联网、移动智能终端等应用的需求。在封装工艺方面，除了传统的 SOT、DFN、QFN 封装工艺外，越来越多的产品采用 WLCSP、SC70 等小型封装以减小体积、提升性能，更加适用于便携式的智能移动终端产品。

报告期内，公司加强了知识产权相关工作的推进力度并取得明显成效，新申请技术专利 31 件（其中发明专利 29 件），申请数量较 2017 年同期有较大增长。同时，新增国内外授权发明专利 11 件，新增授权实用新型专利 4 件，新增转让实用新型专利 2 件，新增 1 件集成电路布图设计登记证书，新增转让集成电路布图设计登记证书 5 件。新增国内外注册商标 15 件。公司荣获全球电子技术领域最大媒体集团 AspenCore 旗下《电子工程专辑》等媒体联合评选的 2018 年度“十大中国 IC 设计公司”奖；公司的大动态高效四通道串联背光 LED 驱动芯片 SGM37604A 在“2018 全球电子成就奖”评选中荣获“年度最佳产品”奖；公司的高速大电流运算放大器产品 SGM8421 荣获 2018 年第十三届“中国芯”优秀产品奖；公司的一项专利“电源控制装置和电源控制系统”获得第五届“北京市发明专利奖”三等奖。

（2）传统领域保持继续增长的同时努力开拓新兴市场：

报告期内，公司在传统领域继续保持稳定的增长。除了传统的模拟芯片市场外，物联网、智能家居、新能源、人工智能、5G 等新应用的涌现也为模拟芯片提供了新的发展机遇。公司紧跟市场发展趋势，在上述新兴领域积极布局、努力开拓。例如智能音箱、扫地机器人、无人机等应用中采用了公司多款高性能信号链产品（如高速比较器、高保真音频驱动芯片、运放等）及电源管理芯片（包括锂电池保护及充电管理芯片、马达驱动芯片、LDO 等）。同时，公司不断加强市场宣传和拓展力度，通过线上、线下等多种形式进行产品的宣传推广：如参加了 2018 慕尼黑上海电子展、2018 德国慕尼黑电子展(electronica 2018)、2018 深圳国际电子展（ELEXCON 2018）；通过平面媒体、新媒体、企业微信公众号等方式推广公司的新产品并取得良好效果。

(3) 加速人才梯队建设，助力公司长效发展：

模拟芯片设计行业存在人才储备不足、进入门槛高等客观因素，引进和培养优秀的模拟设计、生产管理及市场销售人才是公司人力资源工作的重要内容。报告期内，公司从人才引进、内部培养、薪酬考评体系等方面着手，加速了人才梯队建设，引进了多名国内外高端人才。

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，实施了 2018 年股票期权激励计划，用以激发管理团队和核心骨干人员的积极性，增强公司凝聚力，助力公司长效发展。

(4) 建立健全内部控制，不断完善公司治理：

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构。同时，为加强公司的信息披露工作，保证真实、准确、完整的披露信息，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司制定了相关《信息披露管理办法》和《内幕知情人登记备案制度》等，并根据监管要求不断更新修订相关具体内容。董事会、监事会有效的履行相关职责，逐渐规范相关议事规则和工作细则，确保三会工作的顺利开展及完成，完善公司法人治理结构。